

10/521822
PCT/03/50020
Rec'd PCT/PTO 21 JAN 2005

REC'D 31 OCT 2003

WIPO PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 11 AOUT 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

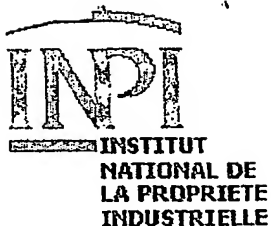
DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



BREVET D'INVENTION

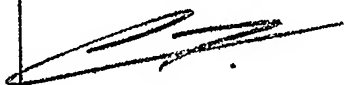
26bis, rue de Saint-Pétersbourg
75800 Paris Cédex 08
Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES: 25 juil. 2002 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: 0209462 DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: 75 DATE DE DÉPÔT: 25 JUL. 2002	Olivier CAMUS Cabinet Christian SCHMIT et Associés 8, place du Ponceau 95000 CERGY France
Vos références pour ce dossier: 10731FR.	

1 NATURE DE LA DEMANDE			
Demande de brevet			
2 TITRE DE L'INVENTION			
		ANTENNE CAPACITIVE ET PROCÉDÉ DE RÉALISATION	
3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICÉ DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE		Pays ou organisation	Date N°
4-1 DEMANDEUR			
Nom	FCI		
Rue	53, rue de Châteaudun		
Code postal et ville	75009 PARIS		
Pays	France		
Nationalité	France		
Forme juridique	Société anonyme		
N° SIREN	349 566 240		
Code APE-NAF	ape		
N° de téléphone	01 53 15 74 22		
N° de télécopie	01 53 15 49 03		
5A MANDATAIRE			
Nom	CAMUS		
Prénom	Olivier		
Qualité	CPI: 02 0300		
Cabinet ou Société	Cabinet Christian SCHMIT et Associés		
Rue	8, place du Ponceau		
Code postal et ville	95000 CERGY		
N° de téléphone	01 30 73 84 14		
N° de télécopie	01 30 73 84 49		
Courrier électronique	info@schmit-associes.com		

DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS		Fichier électronique	Pages	Détails
Description		desc.pdf	8	
Revendications		V	2	10
Dessins			1	5 fig., 3 ex.
Abbrégé		V	1	
Figure d'abrégé			1	fig. 1a; 2 ex.
Désignation d'inventeurs				
Listage des sequences, PDF				
Rapport de recherche				
MODE DE PAIEMENT				
Mode de paiement	Virement bancaire			
Remboursement à effectuer sur le compte n°	27 69			
RAPPORT DE RECHERCHE				
Etablissement Immédiat				
REDEVANCES JOINTES		Devise	Taux	Quantité
062 Dépôt		EURO	35.00	1.00
063 Rapport de recherche (R.R.)		EURO	320.00	1.00
Total à acquitter		EURO		355.00
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE				
Signé par		Olivier CAMUS		
				

Le n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Antenne capacitive et procédé de réalisation

La présente invention a pour objet une antenne capacitive et un procédé de réalisation d'une telle antenne. Elle trouve plus particulièrement son utilisation dans le domaine des applications liées aux technologies de communication sans fil, notamment aux applications d'identification radiofréquence (RFID). Ces applications sont par exemple mises en œuvre pour l'identification automatique et la transmission de données dans les domaines du contrôle d'accès ainsi que de la gestion électronique de données. En matière de contrôle d'accès et ou de porte monnaie électronique, les applications sont par exemple dans le cadre des billets de transports en commun, des péages d'autoroutes, des tickets de parkings, des billets d'avion. De nombreuses sociétés ont également développé des moyens d'identification de leur personnel, ou de leur clientèle, par carte à puce sans contact.

On compte à ce jour deux bandes principales de fréquences mises à profit pour les applications d'identification par radio fréquence : les basses fréquences aux alentours de 125 kHz et les moyennes fréquences aux alentours de 13,56 MHz. Les valeurs de ces fréquences sont généralement fixées et correspondent à des normes internationales. Pour mettre en œuvre cette technologie, on utilise principalement un dispositif de lecture capable de communiquer avec un dispositif nomade porté par un utilisateur. La communication s'effectue par couplage électromagnétique à distance entre une antenne logée dans le dispositif nomade et une deuxième antenne disposée dans le dispositif de lecture.

Le dispositif nomade, ou transpondeur, comporte généralement un support sur lequel sont présentés un dispositif électronique pour élaborer, stocker et traiter des informations, par exemple une puce, et la première antenne avec laquelle le dispositif est relié. Il se présente généralement sous la forme d'une carte de crédit au format ISO ou d'une étiquette souple ("Tag").

Globalement, le prix d'une puce est proportionnel à la surface de silicium utilisée pour loger le microprocesseur, les zones mémoires et les condensateurs. Pour faire baisser de façon significative le coût de l'antenne et du micropackaging de la puce, il est connu dans l'état de la technique de

chercher à diminuer la taille de la puce en diminuant l'encombrement généré par les condensateurs. On utilise donc des puces comportant des condensateurs de faible encombrement et ayant des capacités moindres.

Par conséquent, en parallèle de la diminution de la taille de la puce, à inductance de l'antenne constante, il devient nécessaire que le support présente par ailleurs un autre condensateur pour que la loi de résonance du dispositif soit respectée. Le fonctionnement optimal du dispositif est obtenu à la résonance, lorsque les caractéristiques des différents composants de ce dispositif respectent la loi de résonance suivante:

$$L_a C_p \omega^2 = 1 \quad \text{où}$$

L_a correspond à l'inductance de l'antenne,

C_p correspond à la capacité du dispositif, et

$\omega = 2\pi f$ correspond à la pulsation et se calcule en fonction de la fréquence (f) choisie pour l'échange de signaux.

Comme il est décrit dans le document WO-A-01/50547, il est connu de prévoir une deuxième capacité en parallèle de la puce et de l'antenne. Cette deuxième capacité permet de compenser le fait que la capacité de la puce soit moindre. Notamment ce document enseigne de sérigraphier le condensateur de la même manière que l'antenne est sérigraphiée.

La sérigraphie est dérivée de la technique d'impression au pochoir. Il s'agit d'un procédé d'impression à l'aide d'un écran constitué par un cadre sur lequel est tendu un tissu à maille. Le tissu est généralement constitué de fibre synthétique comme le nylon ou le polyester. Cet écran, appliqué sur le support, reçoit l'encre qui, poussée par une raclette, passe à travers les mailles libres pour réaliser l'impression. L'épaisseur du dépôt imprimé est irrégulière.

Les dispositifs de l'état de la technique posent un problème. En effet, ils permettent d'utiliser des puces plus petites et donc moins chères, mais par contre, ces dispositifs imposent certaines contraintes sur la réalisation de l'antenne. L'antenne est sérigraphiée sur un support. Généralement l'antenne comporte plusieurs spires de telle sorte que le premier plot de l'antenne se trouve à l'intérieur des spires, alors que le deuxième plot de l'antenne se trouve à l'extérieur des spires. Pour connecter la puce et le deuxième condensateur en parallèle de l'antenne, il est nécessaire de relier le condensateur à chacun des deux plots de l'antenne.

Le problème est essentiellement posé dans l'état de la technique par le fait que l'antenne comporte obligatoirement plusieurs spires, étant données les capacités des condensateurs et la loi de résonance à respecter. Le deuxième condensateur est sérigraphié à l'extérieur du centre des spires pour éviter de nuire aux flux traversant et donc à l'inductance de l'antenne. Par conséquent ce deuxième condensateur est facilement connecté au plot extérieur de l'antenne. Pour le connecter au plot intérieur de l'antenne, il est nécessaire de réaliser un pont isolant au dessus des spires au niveau desquelles une liaison conductrice peut ensuite être sérigraphiée.

La réalisation de ce pont est contraignante et rajoute des étapes supplémentaires au procédé de fabrication de l'antenne. Avec la technique de sérigraphie, les condensateurs qui peuvent être obtenus ont une capacité intermédiaire. Cette capacité ne vient pas totalement compléter la diminution de la capacité interne de la puce. Par conséquent pour que la loi de résonance soit respectée, il est nécessaire d'augmenter l'inductance de l'antenne, ce qui est obtenu en augmentant le nombre de spires, et en imposant la réalisation d'un pont pour connecter cette antenne multispire au deuxième condensateur sérigraphié.

Dans l'état de la technique on connaît des condensateurs ayant une capacité plus élevée, et qui pourrait coopérer avec une antenne monospire. Mais dans ce cas de tels condensateurs sont chers, encombrant et réduisent à néant les efforts de réduction des coûts.

L'invention a pour objet de résoudre les problèmes cités et permet de fabriquer des antennes planaires à bas coût et en grand volume en tenant compte des contraintes techniques futures imposées par les fabricants de puce. Selon l'invention il est possible de proposer sur un même support une antenne comportant de préférence une spire unique, cette antenne étant connectée à un condensateur de forte capacité. La capacité d'un condensateur plan se déduit de l'équation suivante:

$$C = \epsilon_0 * \epsilon_r * S / e \quad \text{où}$$

C est la valeur de la capacité,

ϵ_0 correspond à la permittivité diélectrique du vide ($8,854 \cdot 10^{12}$ F/m),

ϵ_r correspond à la permittivité relative du diélectrique,

S correspond à la surface des électrodes en vis-à-vis l'une de l'autre, et

e correspond à l'épaisseur du diélectrique.

Dans l'invention, on obtient un condensateur à capacité élevée en jouant principalement sur la valeur de l'épaisseur de diélectrique qui est disposée entre les deux plaques conductrices. Pour obtenir le résultat de l'invention, le condensateur est imprimé par héliogravure sur le support
5 présentant également l'antenne. En effet, par la technique de l'héliogravure, on obtient le dépôt de couche de très faible épaisseur. Le condensateur est obtenu par dépôt d'au moins trois couches superposées et successives, telles qu'une première couche conductrice, recouverte d'une deuxième couche isolante, et enfin elle même recouverte d'une troisième couche
10 conductrice. Par exemple, l'antenne peut elle-même être imprimée par héliogravure à cette occasion, le design de l'antenne étant finalisé avec les deux couches conductrices.

L'héliogravure est une technique dérivée de la taille-douce. Les éléments imprimants sont en creux. Les zones imprimantes sont gravées sur
15 un cylindre d'acier recouvert de cuivre et chromé. On peut utiliser des solutions chimiques pour graver le cuivre. Il existe aussi des machines qui gravent mécaniquement les cylindres à l'aide d'une pointe en diamant à partir d'un balayage électronique d'une photographie à reproduire. Enfin une autre méthode de préparation des cylindres d'impression utilise un laser pour la
20 gravure. Lors de l'impression, l'encre remplit les alvéoles du cylindre; une racle enlève l'excès d'encre et le support est ensuite pressé contre la forme imprimante pour réaliser le tirage. L'impression qui en résulte est d'une grande qualité et est parfaitement reproductible. L'héliogravure utilise des encres fluides contenant des solvants volatils. Même pour des dépôts de
25 faible épaisseur, on obtient un dépôt couvrant de manière homogène toute la surface à imprimer.

Les avantages liés à ce procédé permettent de garantir une géométrie constante du condensateur plan. Du fait que ce condensateur a une capacité élevée, une antenne même monospire est accordée à la résonance. Par
30 conséquent le condensateur et la puce peuvent être très facilement reliés à l'antenne monospire. La résistance électrique globale de l'antenne monospire est inférieure à la résistance d'une spirale classique. Cela permet d'envisager dans une variante, un dépôt de cuivre électrolytique à grande vitesse avec une épaisseur constante et maîtrisée, au dessus de chacune
35 des zones présentant une portion de couche conductrice.

Ainsi, le procédé inventif permet de réduire très sensiblement le prix du transpondeur en jouant à la fois sur le coût direct de fabrication de l'antenne et sur la simplification du micropackaging de la puce.

5 L'invention a pour objet une antenne de couplage comportant au moins une spire présentée sur un support, et reliée à un condensateur présenté sur ce même support, le condensateur étant monté en parallèle sur deux plots de l'antenne, caractérisée en ce que l'antenne et le condensateur sont imprimés par héliogravure sur le même support.

10 L'invention a également pour objet un procédé de réalisation d'une antenne comportant au moins une spire reliée à un condensateur, l'antenne et le condensateur étant présentés sur un même support isolant caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes:

- réaliser une première impression par héliogravure avec une encre conductrice pour obtenir une spire ouverte de l'antenne, une électrode inférieure du condensateur, et une liaison entre un premier plot de l'antenne et l'électrode inférieure,

- réaliser une deuxième impression par héliogravure avec une encre diélectrique pour recouvrir l'électrode inférieure d'une couche isolante,

20 - réaliser une troisième impression par héliogravure avec une encre conductrice pour obtenir une électrode supérieure du condensateur recouvrant la couche isolante, et pour obtenir une liaison entre un deuxième plot de l'antenne et l'électrode supérieure.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit et à l'examen des figures qui l'accompagnent. Celles ci ne sont présentées qu'à titre indicatif et nullement limitatif de l'invention. Les figures montrent :

25 Figure 1a : une vue de dessus d'un support après une première étape du procédé selon l'invention,

Figure 1b : une vue de dessus d'un support après une deuxième étape du procédé selon l'invention,

30 Figure 1c : une vue de dessus d'un support après une troisième étape du procédé selon l'invention,

Figure 1d : une vue de dessus d'un support après une dernière étape facultative du procédé selon l'invention,

35 Figure 2 : une vue d'ensemble d'une antenne selon l'invention coopérant avec un dispositif de lecture.

La Figure 2 montre un dispositif nomade 1 prévu pour échanger des signaux radioélectriques avec un dispositif de lecture 2. Le dispositif nomade 1 est un transpondeur comportant un microcircuit électronique 3, ou puce 3, et une antenne 4. Par exemple, la puce 3 et l'antenne 4 sont présentées sur un substrat isolant 5. Ce substrat 5 peut par exemple présenter les formes d'une carte à puce standardisée au format ISO. La puce 3 est connectée à l'antenne 4, et est alimentée par le courant induit produit par le champ électro-magnétique émis et reçu dans l'antenne 4.

Le dispositif de lecture 2 comporte une deuxième antenne 6 pour émettre et recevoir des signaux en direction du dispositif nomade 1. Par ailleurs le dispositif 2 comporte un coupleur 7 relié à la deuxième antenne 6, ce coupleur 7 étant par ailleurs relié à une unité 8 de traitement et de gestion des données échangées. L'unité 8 est par exemple un ordinateur.

L'antenne 4 comporte selon l'invention, comme représenté sur les figures 1a, 1b, 1c et 1d, au moins une spire 9 et un condensateur 10 monté en parallèle de la spire 9. La spire 9 et le condensateur 10 sont présentés sur un support 11. Le support 11 est isolant et peut par exemple se présenter sous la forme d'un film mince flexible. Par exemple, le substrat 11 est de type polyéthylène (PE), polyester (PET), polychlorure de vinyle (PVC), polycarbonate (PC), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), verre-époxy, polyimide, papier, etc.

La spire 9 comporte un premier plot 12 et un deuxième plot 13 auxquels le condensateur 10 et la puce 3 seront connectés.

Au cours d'une première étape du procédé de réalisation selon l'invention de l'antenne 4, on dispose le support 11 sous un premier cylindre d'héliogravure alimenté en encre électroconductrice. On réalise ainsi un premier motif dessinant la spire 9, une électrode inférieure 14 du condensateur 10, et une liaison 15 entre le premier plot 12 et l'électrode inférieure 14. Le deuxième plot 13 est déjà apparent dès le dépôt de la première couche d'encre conductrice. Par exemple, l'épaisseur du dépôt d'encre, une fois séchée, est de l'ordre de 2 à 4 micromètres.

Pour former le condensateur 10, on dépose une deuxième couche 16 avec un matériau diélectrique au dessus de l'électrode inférieure 14. Selon l'invention, cette deuxième couche 16 est déposée par héliogravure au moyen d'un deuxième cylindre alimenté avec une encre aux propriétés

isolantes. De préférence cette deuxième couche est obtenu suite à un double passage sous deux cylindres tels que le deuxième cylindre. Ainsi la couche de diélectrique 16 est obtenu par deux couches superposées d'encre isolante. Avec une telle double épaisseur des couches isolantes, on évite les problèmes de porosité dans le diélectrique séparant l'électrode inférieure 14 de l'électrode supérieure 17.

Typiquement, l'épaisseur de la couche isolante 16 est inférieure à 10 micromètres, et varie de préférence entre 5 et 10 micromètres, cette couche 16 étant obtenue de préférence en deux couches successives afin de limiter les porosités génératrices de fuites de courant. La couche de diélectrique est homogène, et ne comporte pas de pores dans lesquels des impuretés pourraient se loger.

Avec la technologie de l'héliogravure, et l'encre spécifique utilisée, la couche 16 peut dans une variante être obtenue en un seul passage sous le deuxième cylindre.

Ensuite, pour finir le condensateur 10, comme présenté Figure 1c, on dépose une troisième couche, pour former l'électrode supérieure 17, et également une liaison 18 entre cette électrode supérieure 17 et le deuxième plot 13. Cette troisième couche est imprimée par héliogravure en utilisant une encre conductrice. Dans ce cas, on utilise de préférence une machine quatre couleurs présentant les quatre cylindres au sein d'une même ligne.

De préférence on utilise la même encre conductrice pour réaliser la première couche et la troisième couche. l'encre utilisée dans l'invention présente une très faible résistance électrique, elle comporte du cuivre, de l'argent, de l'or, du palladium, de l'étain ou des alliages de ceux-ci ainsi que des polymères conducteurs. L'encre conductrice de l'électricité doit être préparée, du point de vue de sa viscosité et du point de vue d'autres propriétés physico-chimiques, de manière qu'elle convienne pour l'héliogravure.

L'encre choisie est par exemple une encre électroconductrice chargée de métal. Dans ce cas le métal est principalement de l'argent, et il est présenté sous la forme de paillettes formant des micro plaques. Ces micro plaques sont de préférence de très faible épaisseur (1 à 2 μm) et d'une longueur comprise entre 2 et 5 μm . La proportion de ces charges métalliques est compris entre 50% et 80% de la masse solide de l'encre. De préférence,

la proportion des charges métalliques est de 70%, pour garantir une forte conductivité de l'encre ainsi formée. L'encre à forte conductivité est en contrepartie de faible résistivité, ce qui facilite l'étape suivante de métallisation.

5 Dans une variante, l'encre peut comporter des polymères organiques conducteurs. L'avantage de ces polymères est qu'ils sont formulés dans une phase solvant ou aqueuse qui permet ainsi d'ajuster les propriétés rhéologiques de l'encre obtenue, pour la rendre notamment compatible avec le procédé d'héliogravure. Un autre avantage vient du fait que dans cette
10 variante, l'encre ne comporte pas de charges métalliques, ce qui contribue à une baisse de coût à grande échelle, et ce qui facilite l'obtention d'une encre homogène permettant de fiabiliser le procédé de fabrication.

Au cours d'une dernière étape, on peut par exemple déposer une couche métallique 19 pour recouvrir toutes les portions présentant de l'encre
15 conductrice que ce soit du premier passage ou du troisième passage. Cette couche métallique peut être déposée par cuivrage électrolytique. L'épaisseur de cuivre déposée est de l'ordre de 5 micromètres et recouvre la spire 9, les plots 12 et 13 les liaisons 15 et 18, et également la face supérieure 17 de l'électrode supérieure du condensateur 10.

20 De préférence, pour accorder l'antenne 4 avec la puce 3, à la fréquence de 13,56 MHz, on choisit une spire 9 de largeur 500 μm telle qu'elle présente une inductance de 270 nH. Ensuite en fonction de la capacité interne de la puce 3, on détermine la capacité du condensateur plan externe 10 qu'il faut prévoir sur le support 11. Par exemple, dans le cas où la
25 capacité de la puce 3 est de 97 pF, sachant qu'on peut obtenir de manière fiable une épaisseur de 8 micromètres pour le diélectrique, on choisit un diamètre des électrodes égal à 11,8 millimètres. Dans une variante, si la capacité de la puce 3 est de 25 pF, alors il est nécessaire que le condensateur plan 10 présente une capacité de 485 pF, et à cet effet,
30 lorsqu'on a une épaisseur de diélectrique de 8 millimètres, on prévoit une surface de condensateur telle que le diamètre vaut 12,8 millimètres.

Dans une variante, dans l'invention, notamment si une seule couche de diélectrique 16 suffit, alors l'épaisseur étant moindre on peut prévoir des modèles d'antennes pour étiquettes électroniques avec des condensateurs
35 10 de très faible encombrement.

REVENDEICATIONS

1 – Antenne (4) de couplage comportant au moins une spire (9) présentée sur un support (11), et reliée à un condensateur (10) présenté sur ce même support, le condensateur étant monté en parallèle sur deux plots (12, 13) de l'antenne, caractérisée en ce que l'antenne et le condensateur sont imprimés par héliogravure sur le même support.

2 – Antenne selon la revendication 1 caractérisée en ce que l'antenne comporte une unique spire et est accordée pour l'émission et la réception d'une onde porteuse à moyenne fréquence.

3 – Antenne selon l'une des revendications 1 à 2 caractérisée en ce que l'antenne est accordée pour une fréquence aux alentours de 13,56 MHz.

4 – Antenne selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisée en ce qu'une épaisseur d'isolant entre deux électrodes du condensateur plan est inférieure à 10 micromètres.

5 – Antenne selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisée en ce qu'elle est connectée à une puce électronique (3).

6 – Procédé de réalisation d'une antenne comportant au moins une spire (9) reliée à un condensateur (10), l'antenne et le condensateur étant présentés sur un même support isolant (11) caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes:

- réaliser une première impression par héliogravure d'une encre conductrice pour obtenir une spire ouverte de l'antenne, une électrode inférieure (14) du condensateur, et une liaison (15) entre un premier plot (12) de l'antenne et l'électrode inférieure,

- réaliser une deuxième impression par héliogravure d'une encre diélectrique pour recouvrir l'électrode inférieure d'une couche isolante (16),

- réaliser une troisième impression par héliogravure d'une encre conductrice pour obtenir une électrode supérieure (17) du condensateur recouvrant la couche isolante, et pour obtenir une liaison (18) entre un deuxième plot (13) de l'antenne et l'électrode supérieure.

7 – Procédé selon la revendication 6 caractérisé en ce que la couche isolante est obtenue par le dépôt successif de deux couches d'encre diélectrique imprimées par héliogravure.

8 – Procédé selon l'une des revendications 6 à 7 caractérisé en ce

qu'il comporte une étape finale consistant à

- déposer une couche métallisée (19) par électrolyse sur les couches apparentes d'encre conductrice, à savoir la spire ouverte de l'antenne, la liaison entre le premier plot de l'antenne et l'électrode inférieure, l'électrode supérieure, et la liaison entre le deuxième plot de l'antenne et cette électrode supérieure.

- 5
- 9 – Procédé selon l'une des revendications 6 à 8 caractérisé en ce qu'on détermine la surface du condensateur à imprimer par héliogravure en fonction de l'épaisseur de la couche de diélectrique qui peut être déposée
- 10 lors de la deuxième impression.

- 10 – Procédé selon l'une des revendications 6 à 9 caractérisé en ce qu'on connecte directement les deux plots de l'antenne à une puce (3) électronique avec laquelle l'antenne coopère.

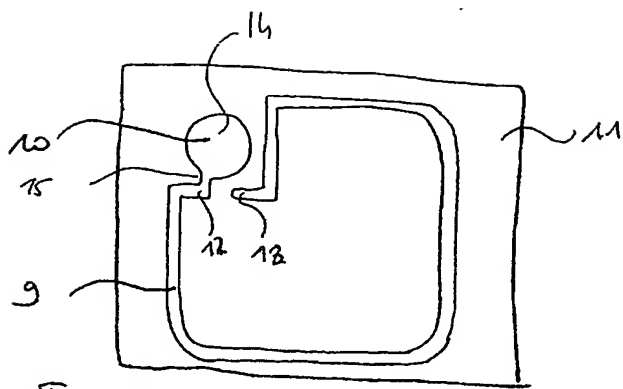


Fig. 1a

4

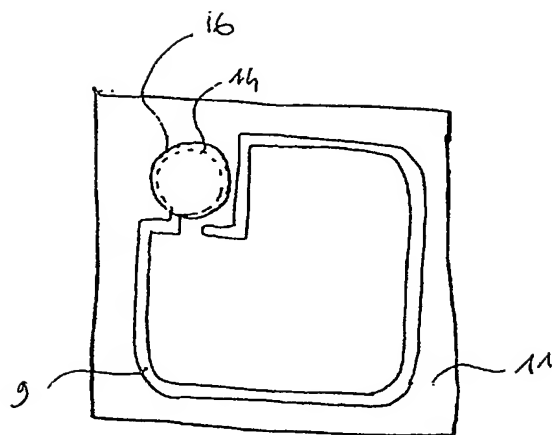


Fig. 1b

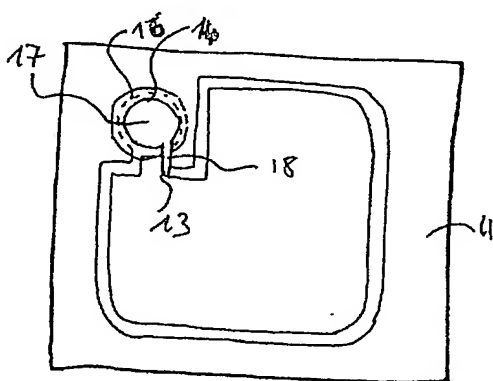


Fig. 1c

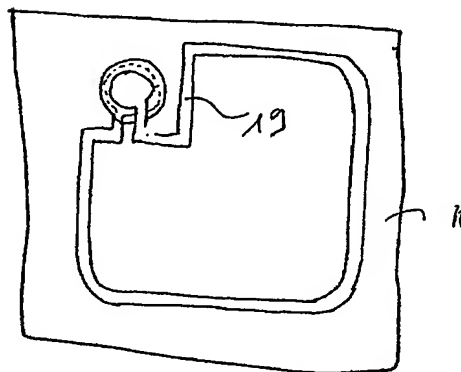


Fig. 1d

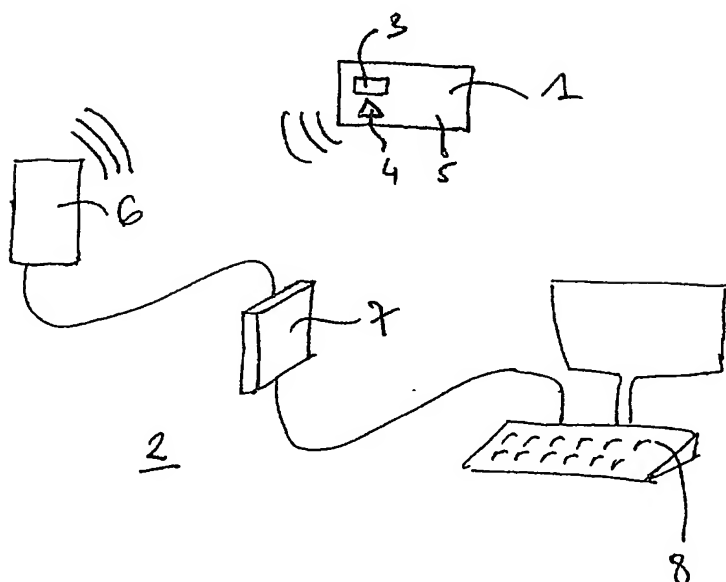
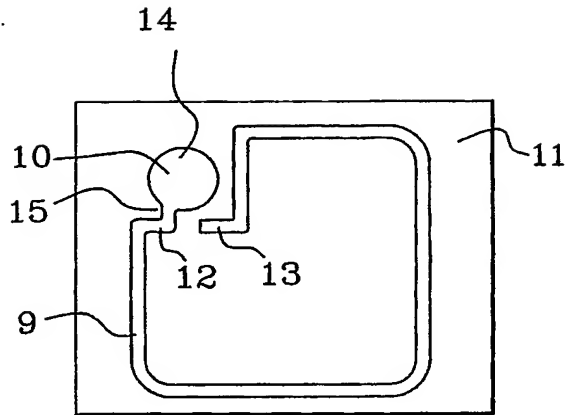


Fig. 2



4
Fig. 1a

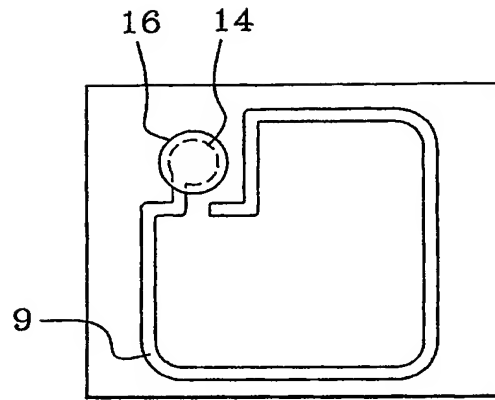


Fig. 1b

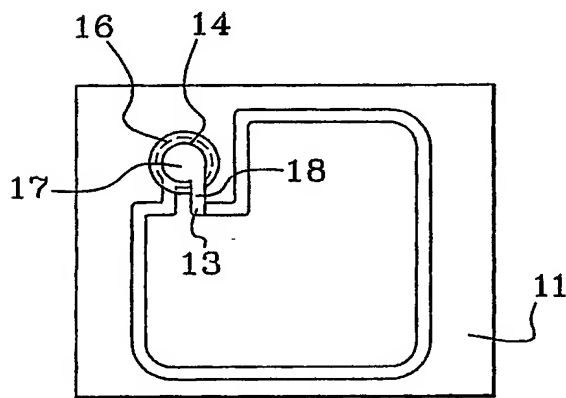


Fig. 1c

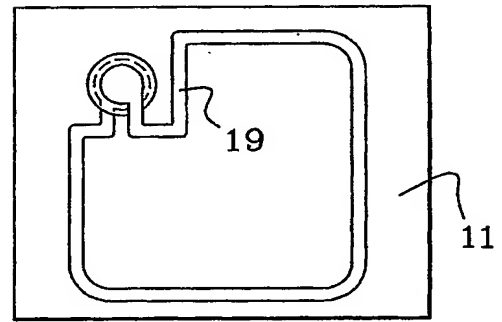


Fig. 1d

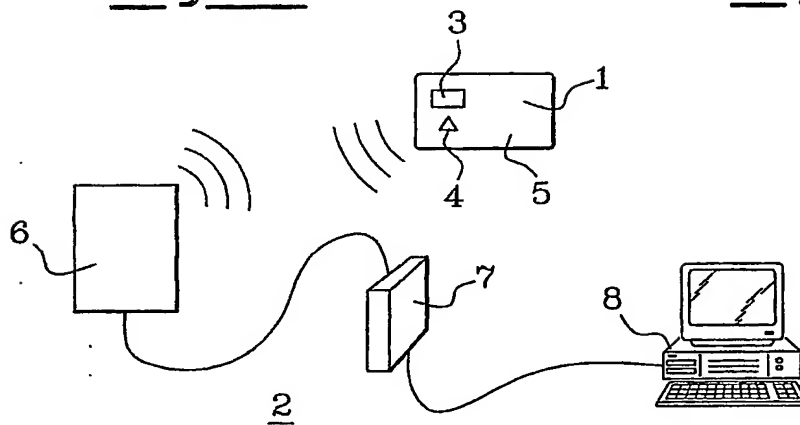



Fig. 2

BREVET D'INVENTION

Désignation de l'inventeur

Nos références pour ce dossier	10731FR.
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL	0209462
TITRE DE L'INVENTION	ANTENNE CAPACITIVE ET PROCÉDÉ DE RÉALISATION
E(S) DEMANDEUR(S) OU LE(S) MANDATAIRE(S):	Olivier CAMUS
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):	
Inventeur 1	
Nom	MATHIEU
Prénoms	Christophe
Rue	16, rue de la Croisette
Code postal et ville	27950 SAINT-MARCEL
Société d'appartenance	
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE	
Signé par:	Olivier CAMUS 
Date	25 juil. 2002

Le n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Il confère un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.